

先端デバイス集積化に向けた3次元集積実装技術と シリコン貫通電極および接合技術の技術開発動向

- ◆日時: 2026年01月29日(木) 13:00~17:00
- ◆会場: 【WEB限定セミナー】※在宅、会社にいながらセミナーを受けられます
- ◆聴講料: 1名につき49,500円(税込、資料付)
- ※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。
 - ・1名でお申込みされた場合、1名につき**46,200円**
 - ・2名同時にお申し込みされた場合、**2人目は無料(2名で49,500円)**

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師:(国研)産業技術総合研究所 ハイブリッド機能集積研究部門 3D集積システムグループ
研究グループ長 博士(工学) 菊地 克弥 氏

生成AIといった新しいアプリケーションの出現などにより、AI・量子技術への注目が高まっている。これらの根幹となる半導体デバイスや量子デバイスにおいて、集積化技術が求められており、その中でも、三次元の縦方向へ集積化する3次元集積実装技術への注目が非常に高まっている。この講座では、その3次元集積実装技術のシリコン貫通電極および接合技術の技術開発動向について解説する。

1. 半導体実装技術の基礎

1-1 半導体実装技術の役割

1-2 半導体実装技術の歴史

2. 先端半導体実装技術への要求仕様

2-1 半導体集積化技術としての先端半導体実装技術

2-2 2.5D、3D集積実装技術

3. 3次元集積実装技術の研究開発

3-1 国家プロジェクトにおける3次元集積実装技術の研究開発

3-2 シリコン貫通電極技術開発

3-3 ハイブリッド接合技術を含む微細電極接合技術開発

4. 3次元集積実装技術のさらなる展開に向けて

4-1 超伝導量子コンピュータの大規模集積化に向けた3次元集積実装技術

4-2 超伝導パンプ接続技術

4-3 超伝導直接接合技術

5. まとめ

『先端デバイス集積化【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学		
-------	--	--

住 所	〒	
-----	---	--

電話番号		FAX	
------	--	-----	--

お名前	所属・役職	E-Mail
-----	-------	--------

①		
---	--	--

②		
---	--	--

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。	<input type="checkbox"/> Eメール	<input type="checkbox"/> 郵送
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

● Webセミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしまして、別途視聴用のURLをメールにお送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的に受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧下さい。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧下さい。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>



株式会社 R & D 支援センター

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル7階
TEL) 03-5857-4811 FAX) 03-5857-4812 URL) <https://www.rdsc.co.jp/>